

MPX306型120 欧姆卡接式数字配线架（DDF-720系统）

产品名称	MPX306型120 欧姆卡接式数字配线架（DDF-720系统）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

MPX306型120 欧姆卡接式数字配线架（DDF-720系统）

「PTTP普天泰平 @MPX01数字配线架/柜，MPX01-120 欧姆卡接式DDF数字配线架/柜」MPX01-120欧姆卡接式数字配线架|MPX01-120欧姆卡接式数字配线柜|MPX01-120欧姆卡接式敞开式单面数字配线架|MPX01-120欧姆卡接式敞开式双面数字配线架|DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统/16回路、10系统/20回路、16系统/32回路、20系统/40回路、21系统/42回路数字配线架】(DigitalDistributionFrame)YD/T1437-2014数字配线架通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

PTTP MPX01-120欧姆卡接式数字配线架特点：

本设备为单元式结构，使用120 单元体，方便安装、使用和扩容；

流线型设计，外形美观；

采用"绝缘层位移气密性卡接"技术，操作方便；

体积小、密度高；

机架采用开架式结构，设计简洁，并有完善的线缆管理系统；

布线整齐、美观；

标识清晰、清楚；

有完善的接地系统；

机架、支架均采用静电环氧喷塑，外形美观，防腐性能强；

机架材质可选择高强度铝型材和钢制材料，适合大、中、小型交换局

DDF数字配线架系列众多：西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；2.性能：严格的结构设计、的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；3.结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计，确保客户使用更加方便。

DDF采用标准化程度较高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如如有完善的接地系统。

PTTP MPX01数字配线架(120)

产品品牌：PTTP普天泰平

产品介绍： MPX01-A数字配线架配线设备的阻抗为120 。适用于传输速率2Mbit/s的数字传输设备端口之间或与程控交换设备端口之间的配线连接，从而为电路群的数字信号提供调线、转接、监测等功能。产品特点：

1. 机架采用铝合金型材，机架美观大方。
2. 架内布线空间宽敞，电缆走线清晰美观。
3. 模块标识清晰明确，接线采用卡接。
4. 模块采用高弹性材料、双十字接点，接触可靠。

5. 卡接、剥皮、切断同时完成。
6. 测试部件齐全，能满足用户进行各种测试。
7. 机架适合于单机、并机等多种安装方式。

主要技术参数工作速率：2Mbps特性阻抗：120 回波损耗： 18dB回线间串音防卫度： 60dB导线卡接处接触电阻： 3m 簧片接触处电阻： 7m 绝缘电阻： 1000M (500VDC)MPX01-A单面数架规格尺寸

机架尺寸（单列）高*宽*深

单列模块数（块）

*大容量（系统）

2600*300*300

13

208

2200*300*300

10

160

2000*300*300

9

144

MPX01-A双面数架规格尺寸

单列尺寸（mm）高*宽*深

列模块数（块）

容量（系统）

备注

2600*260*800

13*2

416

特殊设计

2200*260*800

10*2

320

2000*260*800

9*2

288

MPX01型数字配线架(120)

· 采用模块式结构，安装配置灵活、方便。
采用专用的卡接工具和绕接工具，可以快速方便地进行接线工作。

产品介绍：

32回线卡接式模块

32回线卡接式模块

32回线双卡式模块备附件

64回线卡接式模块

64回线卡接式模块备附件

32回线双卡式模块

32回线卡接式模块 备附件

48回线卡接式模块

24回线卡接式模块

24回线卡接式模块 48回线卡接式模块 备附件

24回线绕接式模块

32回线绕接式模块

24、32回线绕接式模块备附件

产品特点：

- 采用模块式结构，安装配置灵活、方便。
- 采用专用的卡接工具和绕接工具，可以快速方便地进行接线工作。

工作条件：

- 工作温度：+5 ~ +40
- 相对湿度：85%(+30 时)
- 大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求：

- 特性阻抗：75
- 工作速率：2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s

- 接触电阻：a)外导体 2.5mΩ，经机械耐久性试验后增值 2.5mΩ b)内导体 10mΩ，经机械耐久性试验后增值 10mΩ
- 绝缘电阻：1000MΩ，测量回路的电压为500V(DC)。
- 耐压：能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。
- 回线间串音防卫度：70dB(50kHz~233MHz)
- 介入损耗：0.3dB(50kHz~233MHz)
- 回波损耗：18dB(50kHz~233MHz)
- 拉脱力：同轴连接器与电缆连接后，抗电缆拉伸能力 > 50N
- 机械耐久性：同轴连接器插拔1000次后，接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求，并且接触面仍有电镀层，不露出基底材料。

订货指南：

型号

外观尺寸

*大容量

备注

高×宽×深(mm)

MPX01型数字配线架 (120)

2600 × 600 × 300

16系统/模块 192系统/ (12模块) /列 384系统 (2列) /架

1.封闭式。 2.单面架。

2200 × 600 × 300

16系统/模块 128系统 (8模块) /列 256系统 (2列) /架

2000 × 600 × 300

16系统/模块 96系统 (6模块) /列 192系统 (2列) /架

2600 × 600 × 450

16系统/模块 192系统/ (12模块) /列 768系统 (4列) /架

1.封闭式。 2.双面架。

2200 × 600 × 450

16系统/模块 128系统 (8模块) /列 512系统 (4列) /架

2000 × 600 × 450

16系统/模块 96系统 (6模块) /列 384系统 (4列) /架

2600 × (N × 250) × 450

16系统/模块 192系统 (12模块) /列

1.敞开式机架结构。 2.宽度为N × 250mm。 3.双面架。

2200 × (N × 250) × 450

16系统/模块 128系统 (8模块) /列

2000 × (N × 250) × 450

16系统/模块 96系统 (6模块) /列

2600 × 600 × 300

24系统/模块 192系统 (8模块) /列 384系统 (2列) /架

1.封闭式。 2.单面架。

2200 × 600 × 300

24系统/模块 144系统 (6模块) /列 288系统 (2列) /架

2000 × 600 × 300

24系统/模块 120系统 (5模块) /列 240系统 (2列) /架

2600 × 600 × 450

24系统/模块 192系统 (8模块) /列 768系统 (4列) /架

1.封闭式。 2.双面架。

2200 × 600 × 450

24系统/模块 144系统 (6模块) /列 576系统 (4列) /架

2000 × 600 × 450

24系统/模块 120系统 (5模块) /列 480系统 (4列) /架

2600 × (N × 250) × 450

24系统/模块 192系统（8模块）/列

1.敞开式机架结构。 2.宽度为 $N \times 250\text{mm}$ 。 3.双面架。

$2200 \times (N \times 250) \times 450$

24系统/模块 144系统（6模块）/列

$2000 \times (N \times 250) \times 450$

24系统/模块 120系统（5模块）/列

建信股权首席投资官李瑞指出：“数据中心市场已成为全球半导体产业的重要增长点，东数西算等大型工程的实施，进一步提升了对DPU这类数据中心核心芯片的需求。”

DPU差异化竞争成市场新热点

后摩尔时代，随着带宽不断提升，海量数据涌入，一些“CPU做不好，GPU做不了”的复杂数据处理工作，如网络协议处理、存储压缩、数据加密等，开始逐渐转向能够重新分配算力和优化算力资源的DPU。DPU因此被列为CPU、GPU之外的第三个主力芯片，成为新一代数据中心创新范式。

赛迪顾问的数据显示，从2023年开始，全球DPU市场规模将突破百亿美元，并进入年增长率超过50%的高速快车道。其中，中国DPU市场规模在2023年将超过300亿元，实现跳跃式增长。

阿里巴巴集团研究员、阿里云弹性计算产品线负责人张献涛坦言，对于云厂商而言，DPU是一个软硬件技术栈结合极其密切的工作，是软件定义的计算架构，DPU必须以自研为主，做到相关软硬件技术栈完全可控，且经过超大规模验证，而生产通用DPU的公司很难满足云厂商的需求。

一方面，云计算市场集中度较高，伴随云计算业务规模持续扩大，资源争抢、算力损失、性能瓶颈等问题日益严峻，云厂商迫切需要寻求破局之法。而通过虚拟化的方式减轻CPU内核负担，实现降本增效的DPU就成了云厂商不得不做的选择。另一方面，云厂商对于自身业务需求更为了解，因此自研DPU事半功倍。此外，DPU是由软件定义的架构，由客户需求或业务发展形态驱动，与客户整个后端软件栈结合非常紧密，很难做到通用程度。相较之下，云厂商更有机会获得差异化竞争优势。